

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-282513

(P2003-282513A)

(43) 公開日 平成15年10月3日 (2003.10.3)

(51) Int. Cl.	識別記号	F I	テームコード (参考)
H 01 L 21/304	6 4 2	H 01 L 21/304	6 4 2 A 4 G 0 6 8
	6 4 7		6 4 7 Z 4 G 0 7 5
B 01 J 4/00	1 0 1	B 01 J 4/00	1 0 1 5 F 0 4 3
19/10		19/10	5 F 0 4 6
H 01 L 21/027		H 01 L 21/30	5 7 2 B

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 6 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2002-85385 (P2002-85385)

(22) 出願日 平成14年3月26日 (2002.3.26)

(71) 出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72) 発明者 進藤 昭則

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(74) 代理人 100110658

弁理士 柳瀬 聡彦 (外3名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機物剥離方法及び有機物剥離装置

(57) 【要約】

【課題】有機物除去についてその薬液寿命の延長化及び高効率処理を可能とする有機物剥離方法及び有機物剥離装置を提供する。

【解決手段】有機物を剥離する処理槽に所定の薬液を蓄える（処理S1）。一方、別槽では上記薬液内に活性剤として加えられるべき液体をミスト化しておく（処理S2）。ミスト化された液体が清浄ガスと混合され処理槽内へ泡状になって供給される（処理S3）。この状態で被処理物が処理槽に投入され、有機物の剥離処理が行われる。被処理物は、例えば剥離すべきレジスト層の付いた半導体ウェハ、また、パーティクル除去すべき半導体ウェハ、また、その他の加工品、各種製造装置内の部品等、有機物除去したいものであれば適用できる。薬液は、例えば硫酸-過酸化水素水混合液であって、ミスト化する液体は過酸化水素水である。

